

2008年度(平成20年9月期) 第56期 第2四半期決算説明会

(平成20年4月1日～平成20年9月30日)

2008年11月5日

Tokyo Cathode Laboratory Co., Ltd.

©Copyright 2008 TCL All rights reserved

Contents

【連結】

1. 第2四半期業績比較と2008年度予想
2. 売上推移と2008年度見通し
3. セグメント別比較
4. セグメント別年度推移

1. 第2四半期業績比較と2008年度予想

【連結】 区 分	平成19年9月期 【実績】		平成20年9月期 【実績】		対前年比	
	金額(百万円)	百分比 (%)	金額(百万円)	百分比 (%)	増減(百万円)	増減率(%)
売上高	7,336	100.0	7,308	100.0	△ 28	△ 0.4
売上原価	5,230	71.3	5,556	76.0	325	6.2
売上総利益	2,106	28.7	1,752	24.0	△ 353	△ 16.8
販売費及び一般管理費	1,782	24.3	1,878	25.7	96	5.4
営業利益	323	4.4	△ 126	△ 1.7	△ 450	—
経常利益	339	4.6	△ 118	△ 1.6	△ 458	—
当期純利益	53	0.7	△ 153	△ 2.1	△ 207	—

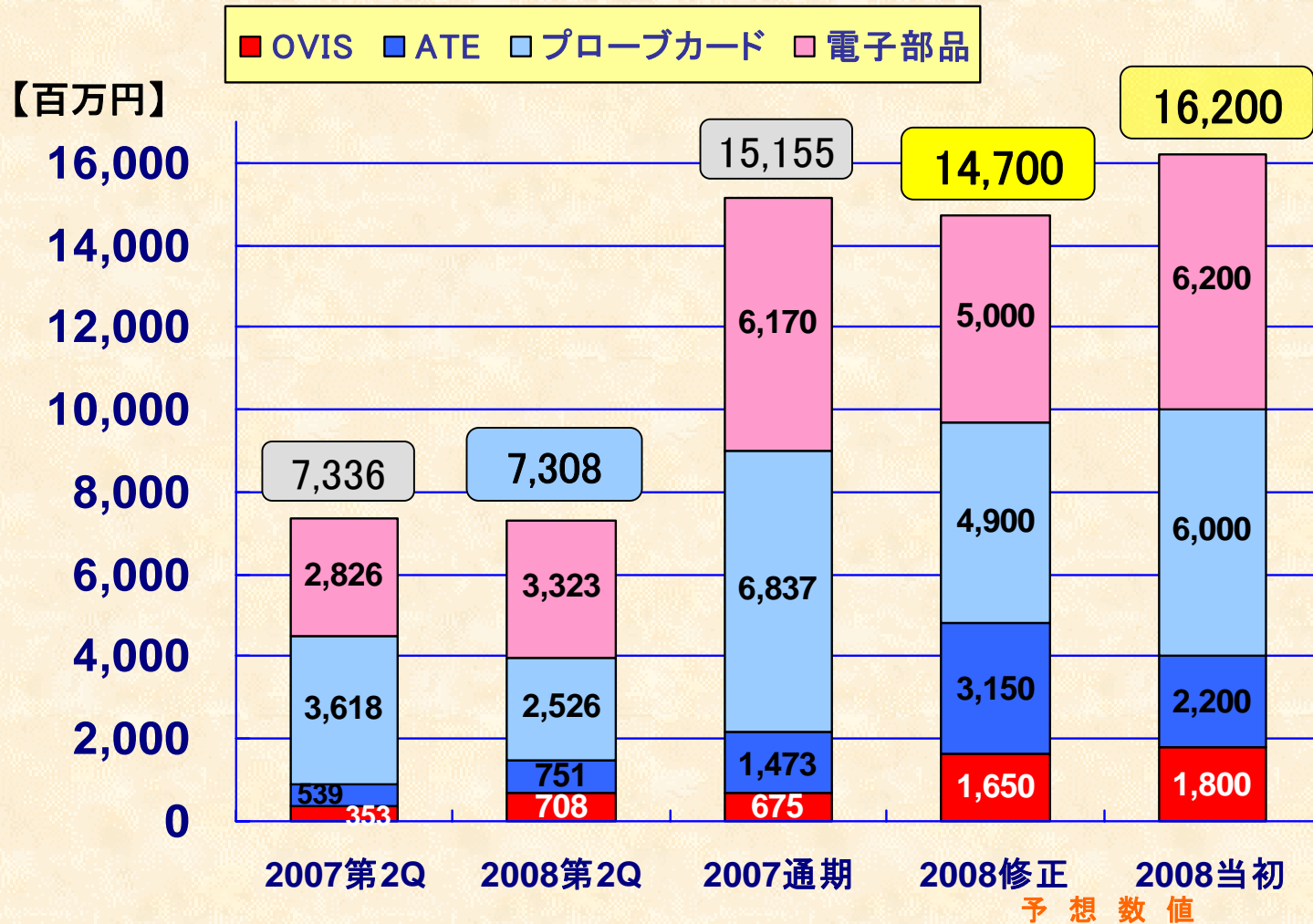
【平成21年3月期】＜(通期) 連結業績予想＞

(単位:百万円)

発表日	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
2008年10月31日 決算発表	14,700	△ 500	△ 460	△ 457

※ 2008年10月24日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。

2. 売上推移と2008年度見通し



※ 2008年度より、事業の種類別セグメント区分を変更しております。

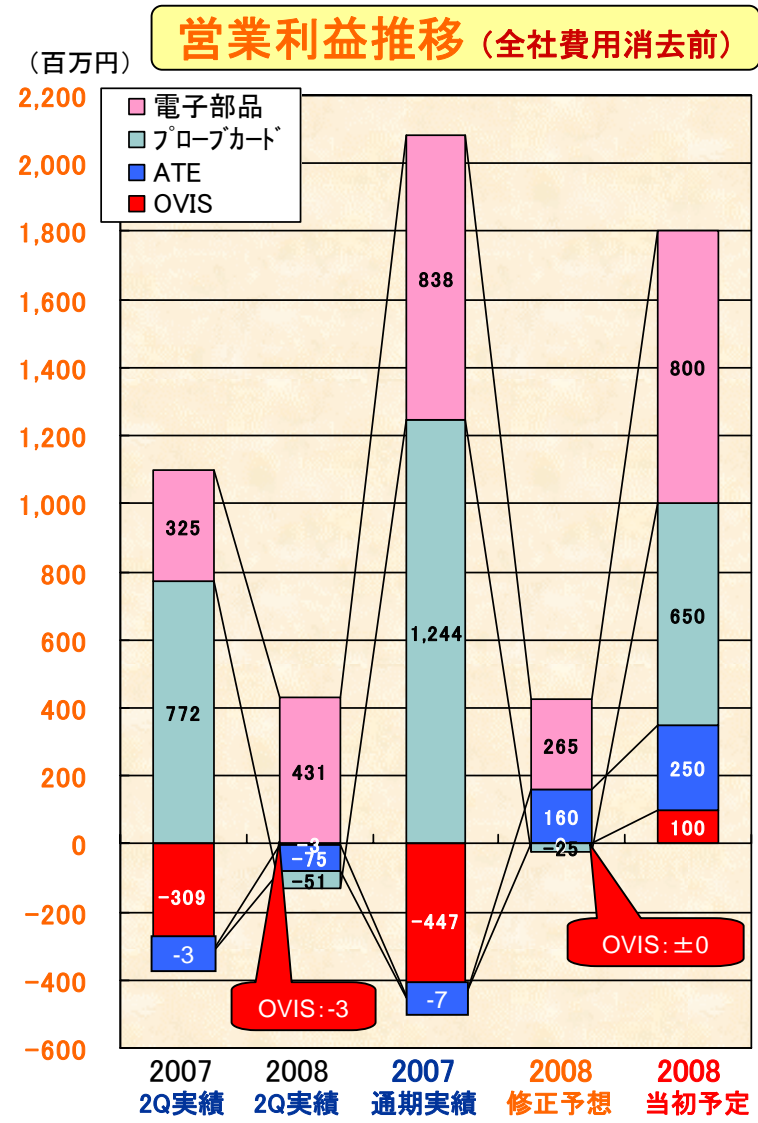
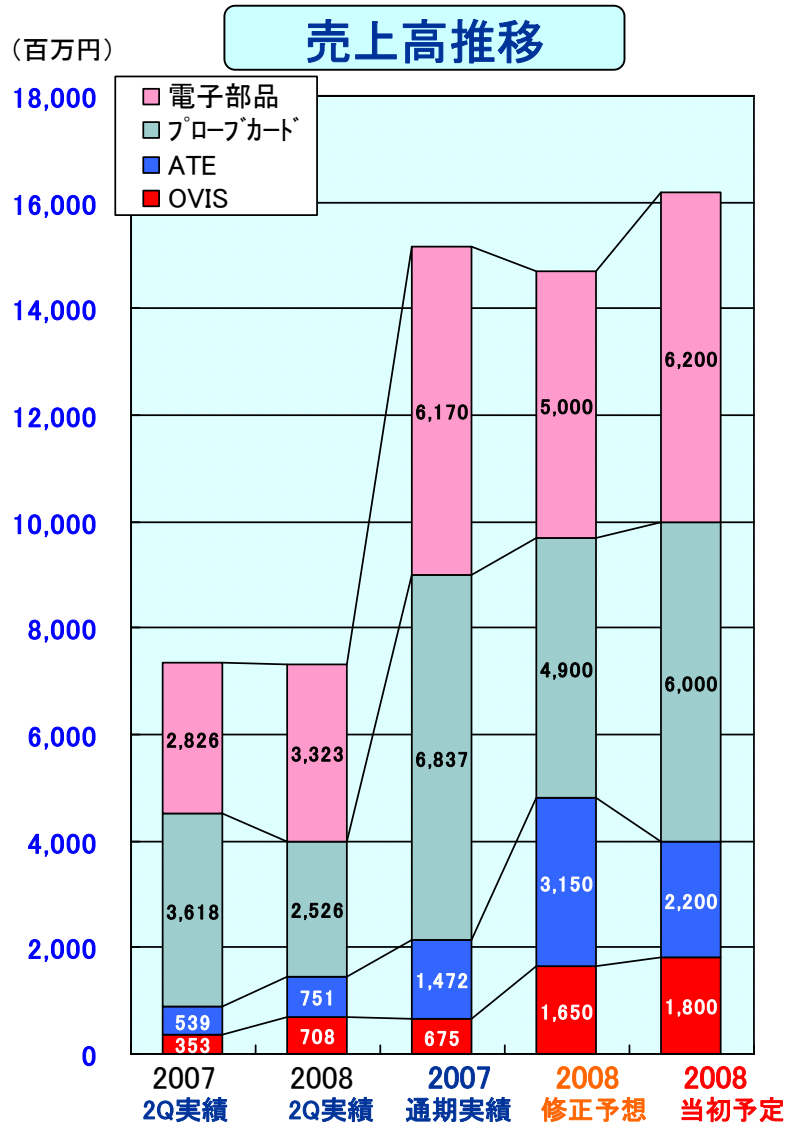
3. セグメント別比較

(単位:百万円、%)

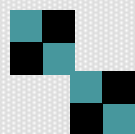
セグメント		平成19年9月期	平成20年9月期	平成20年3月期	平成21年3月期		平成21年3月期	
		2Q 実績	2Q 実績	通期 実績	<修正予想>	対前年比	<当初予定>	対前年比
電子部品 事業	売上高	2,826	3,323	6,170	5,000	81.0%	6,200	100.5%
	営業損益	325	431	838	265	31.6%	800	95.4%
	利益率	11.5%	13.0%	13.6%	5.3%		12.9%	
プローブカー ド 事業	売上高	3,618	2,526	6,837	4,900	71.7%	6,000	87.8%
	営業損益	772	-51	1,244	-25	-2.0%	650	—
	利益率	21.3%	-2.0%	18.2%	-0.5%		10.8%	
A T E 事業	売上高	539	751	1,472	3,150	213.9%	2,200	149.4%
	営業損益	-3	-75	-7	160	—	250	—
	利益率	-0.6%	-10.0%	-0.5%	5.1%		11.4%	
O V I S 事業	売上高	353	708	675	1,650	244.3%	1,800	266.5%
	営業損益	-309	-3	-447	0	0.0%	100	—
	利益率	-87.5%	-0.4%	-66.2%	0.0%		5.6%	
(小 計)	売上高	7,336	7,308	15,155	14,700	97.0%	16,200	106.9%
	営業損益	784	300	1,627	400	24.6%	1,800	110.6%
消去又は全社	売上高	—	—	—	—		—	
	営業損益	-460	-426	-823	-900		-850	
合 計	売上高	7,336	7,308	15,155	14,700	97.0%	16,200	106.9%
	営業損益	323	-126	804	-500	-62.2%	950	118.1%
	利益率	4.4%	-1.7%	5.3%	-3.4%		5.9%	

※ 2008年度より、セグメント区分を変更しており、過年度ATE、OVIS事業は、従来の装置事業より分離して表示しております。

4. セグメント別年度推移



2008年度 第2四半期決算説明会



2008年度 第2四半期決算報告 電子部品事業

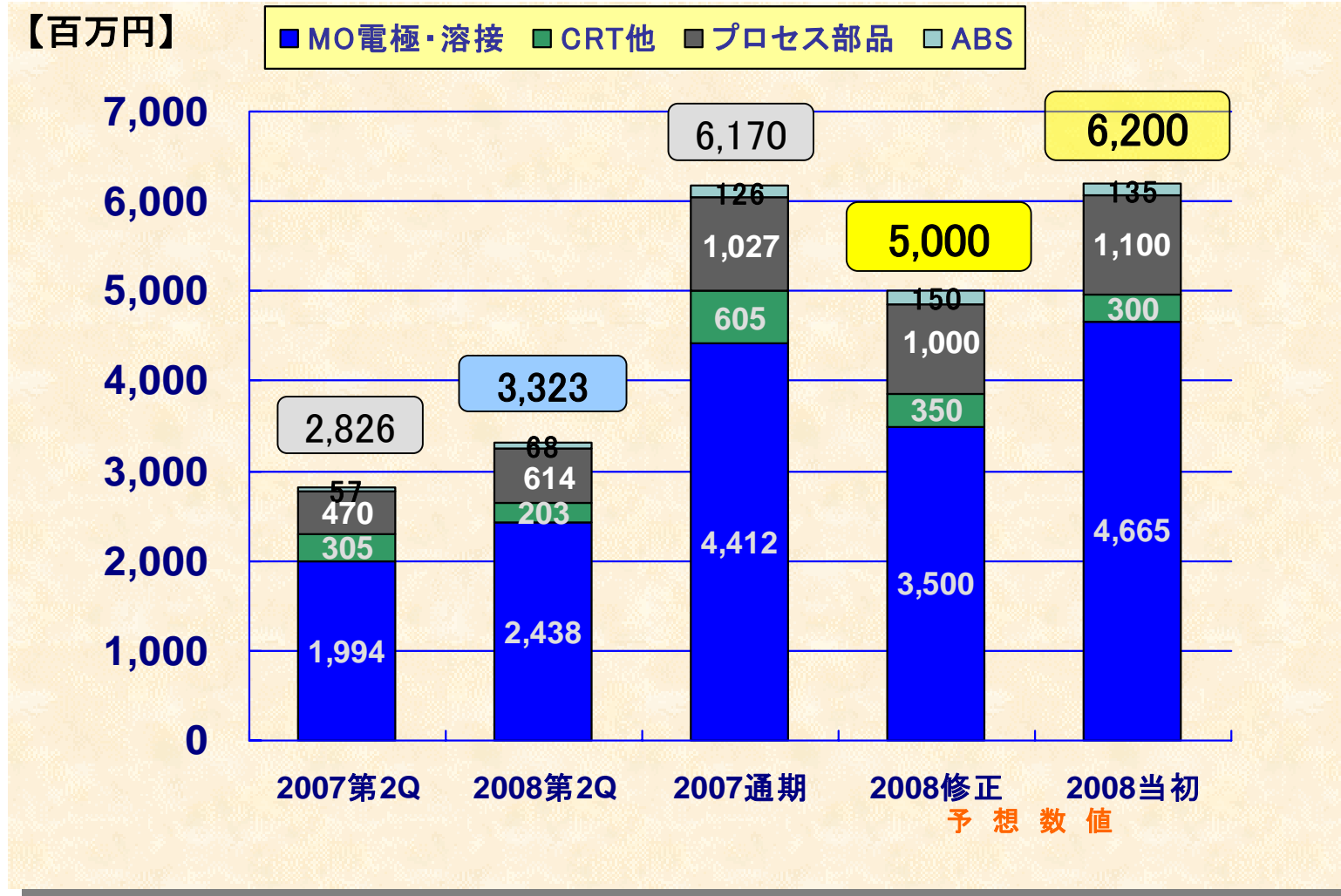
Contents

【連結】

1. 売上推移と2008年度見通し
2. Mo CUP(組立品含む)数量実績・予測
3. 半導体部品
4. 今後の対応

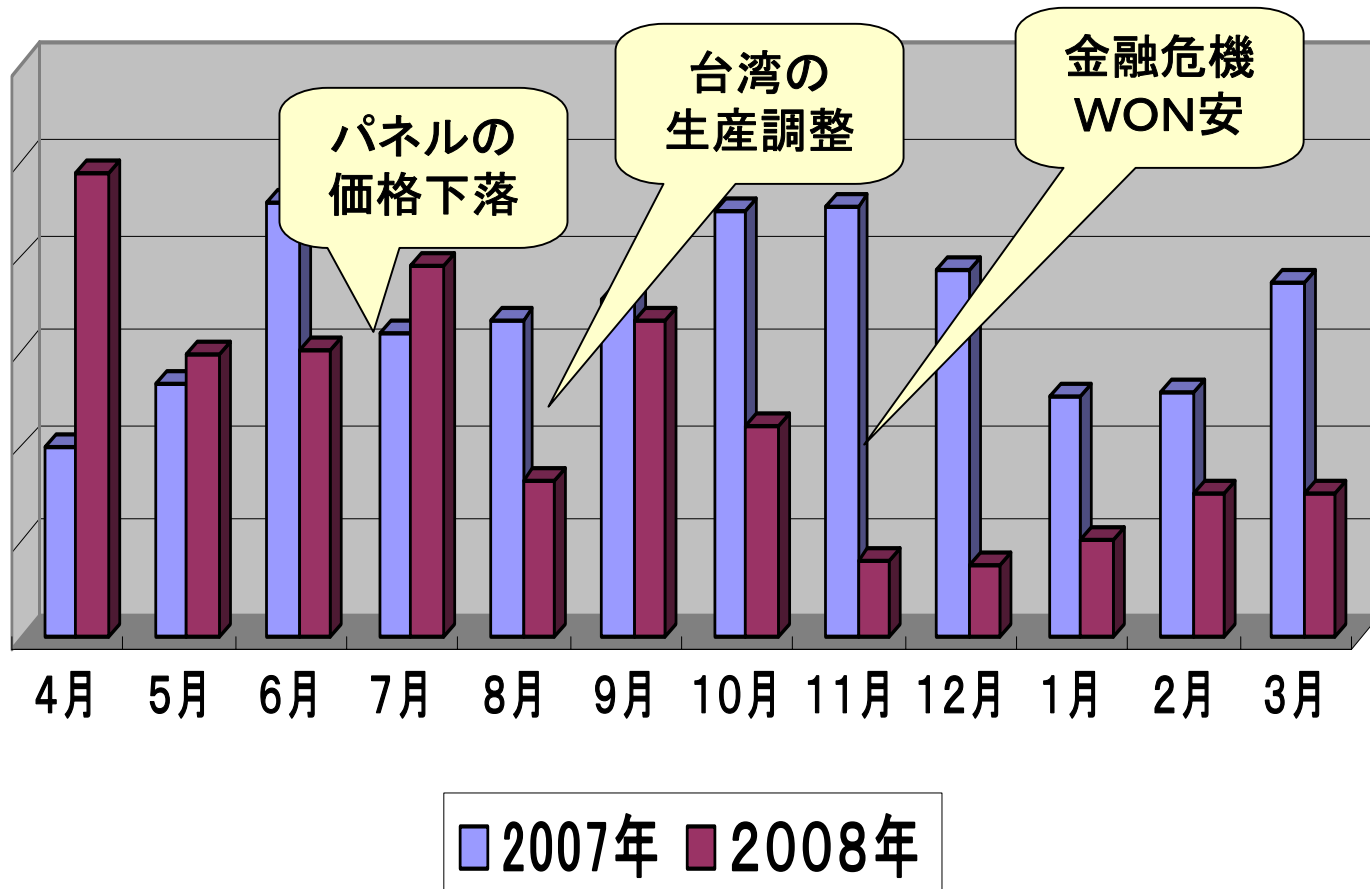
1. 売上推移と2008年度見通し

電子部品事業



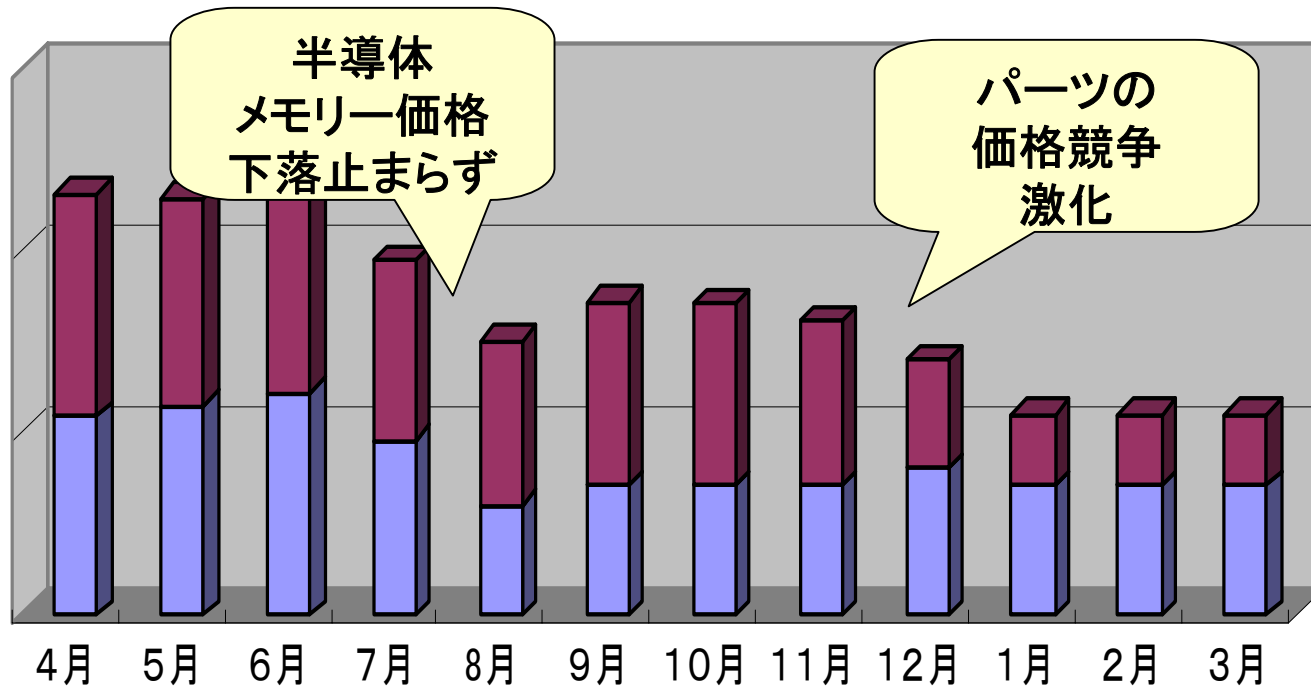
2. Mo CUP(組立品含む)数量実績と予測

Mo CUP 出荷数量



3. 半導体部品

半導体部品 売上



■ アルミパーツ ■ その他パーツ

4. 今後の対応

電極

■ Mo電極長尺物の早期立ち上げ

来年からNiでは4mmΦのCCFLが立ち上がり、Moは従来の3.4mmΦのCCFLでも長い電極タイプが立ち上がるので、Moの長尺電極の組み立てラインの早期立ち上げを行う。

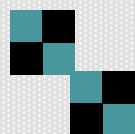
■ 溶接のコスト低減

Mo電極のCCFLがNiの価格に押され、価格が下がっているので、工程の品質管理強化による歩留アップ等でこれに対抗していく。

半導体部品

■ 顧客開拓と拡販

新しい顧客への売り込み強化と、数量増による量産効果でのコスト低減を図り、価格でのメリットを含め、拡販をしていく。



2008年度 第2四半期決算報告 プローブカード事業

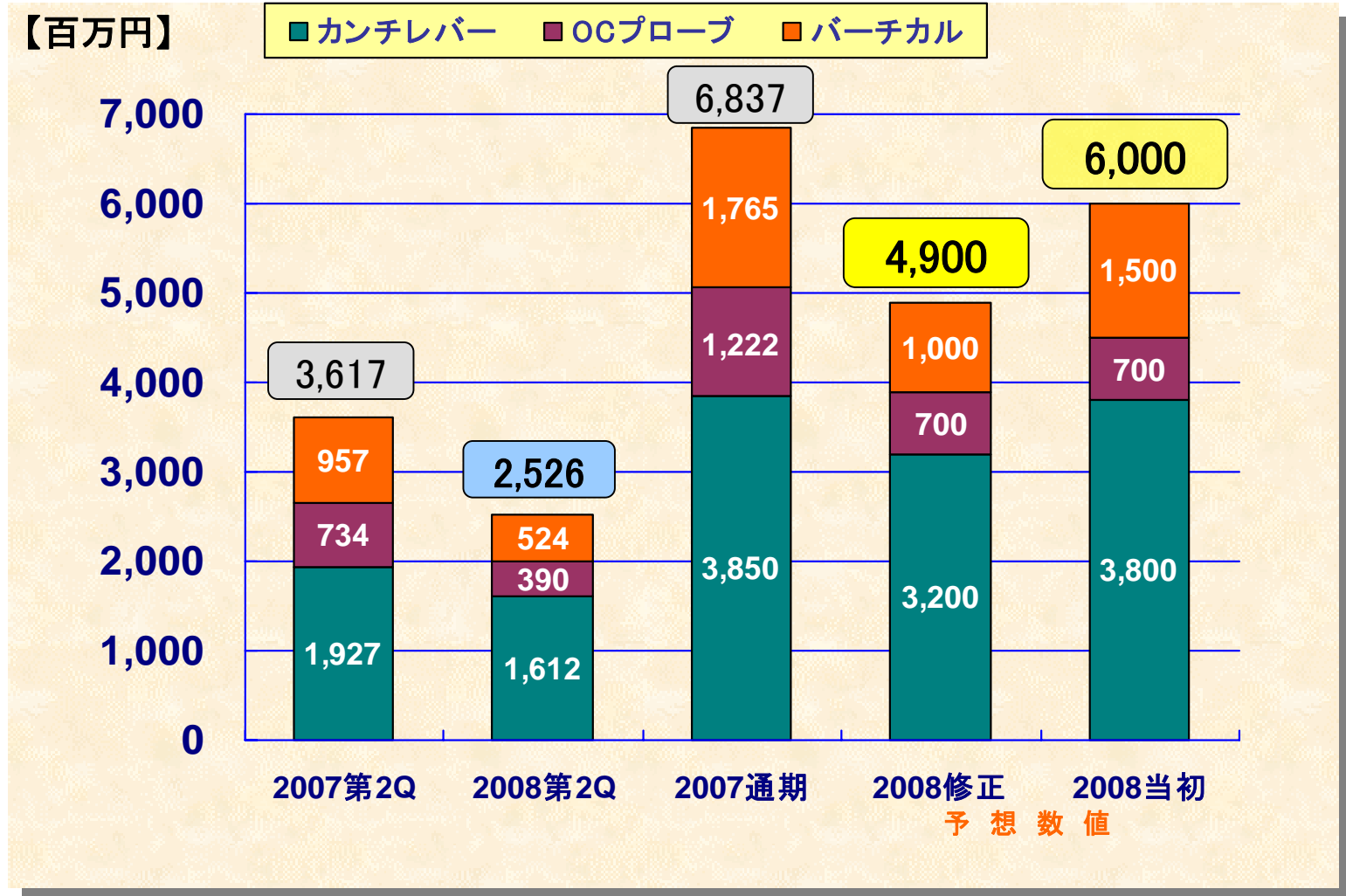
Contents

【連結】

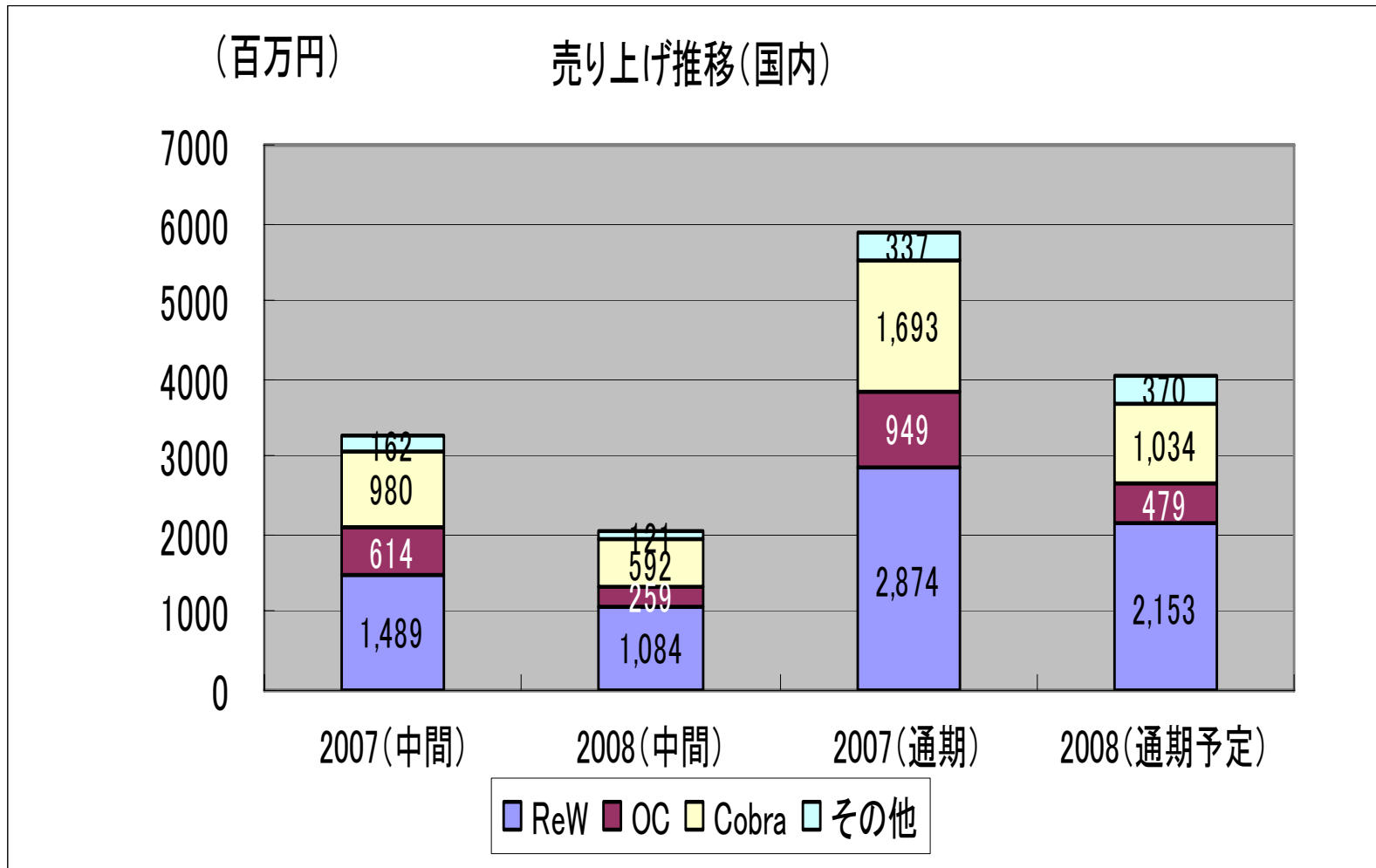
1. 売上推移と2008年度見通し
2. 主要製品別状況
3. プローブカード事業分析

1-1. 売上推移と2008年度見通し

プローブカード事業



1-2. 【国内】売上推移と2008年度見通し



OC,Cobraの落ち込みが大きい

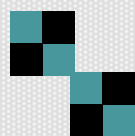
3. プローブカード事業分析

■上期の状況分析

2008年度上期の売り上げは、前年同期に比べて大幅なマイナスになりました。カンチレバー・Cobra共に各ユーザーの生産減少・コストダウン要求が影響し、特にLCDドライバーに於いて主力顧客の生産量は大型パネル、携帯用共に減少傾向にあり、OCプローブの売り上げ・利益を圧迫する結果になりました。

■下期の動向予想

2008年度下期も、各ユーザーの生産減少は続くものと考えております。LCDドライバーは、海外シフトが進み、日本国内での市場はさらに縮小される傾向であると推測しております。客先動向については、狭ピッチ・多数個取りの展開がさらに進み、効率UP・トータルコスト削減への要望が強くなっていくものと思われれます。



2008年度 第2四半期決算報告

ATE事業 (Advanced Test Equipments)

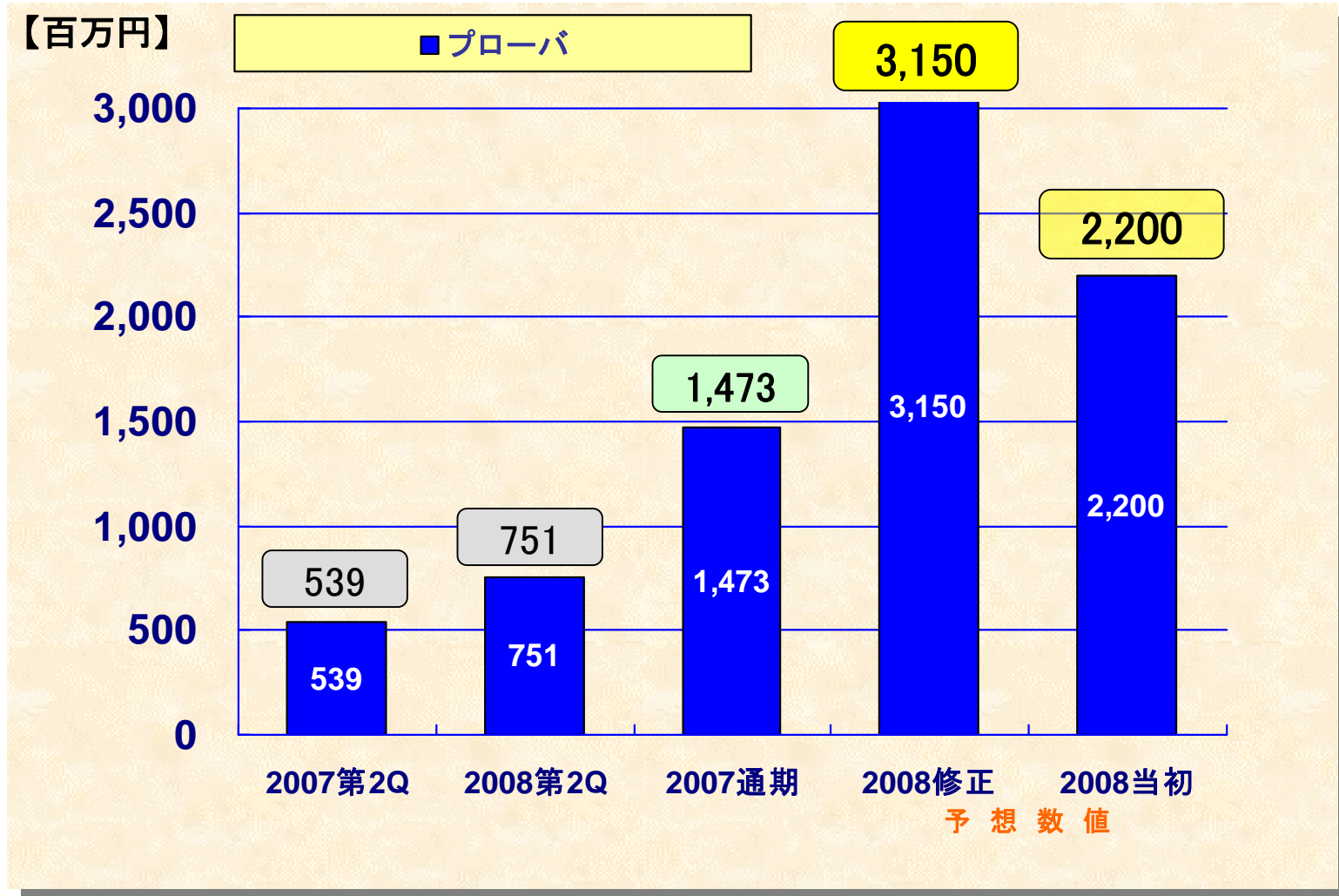
Contents

【連結】

1. 売上推移と2008年度見通し
2. 受注、売上進捗状況
3. 今後の課題と事業戦略

1. 売上推移と2008年度見通し

ATE事業 (過年度は、従来の装置事業より「プローバ」を分離して表示しております。)



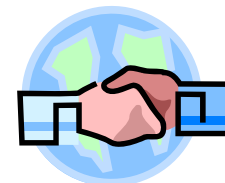
2. 受注、売上進捗状況

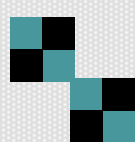
- LDAS+ (非接触Open/Shortテストシステム)
 - 今年度は、国内および海外向け装置の商談がほぼ終了し、過去最大の受注を獲得しました。
 - 売上は、下期(2008年10月～2009年3月)に集中しております。
 - 国内向けLCDおよびPDPの第10世代向け装置の受注に成功し、下期に納入します。

3. 今後の課題と戦略

■ Open/Short検査システムの拡大

- 検出率のさらなる向上をめざし、開発チームを再編成しました。
- 協力会社との協業による、増産および短納期体制の確立を行いました。
- 主要部材の海外調達を進め、約15%程度のコストダウンを達成しました。





2008年度 第2四半期決算報告

OVIS事業 (Optical Vision Inspection System)

Contents

【連結】

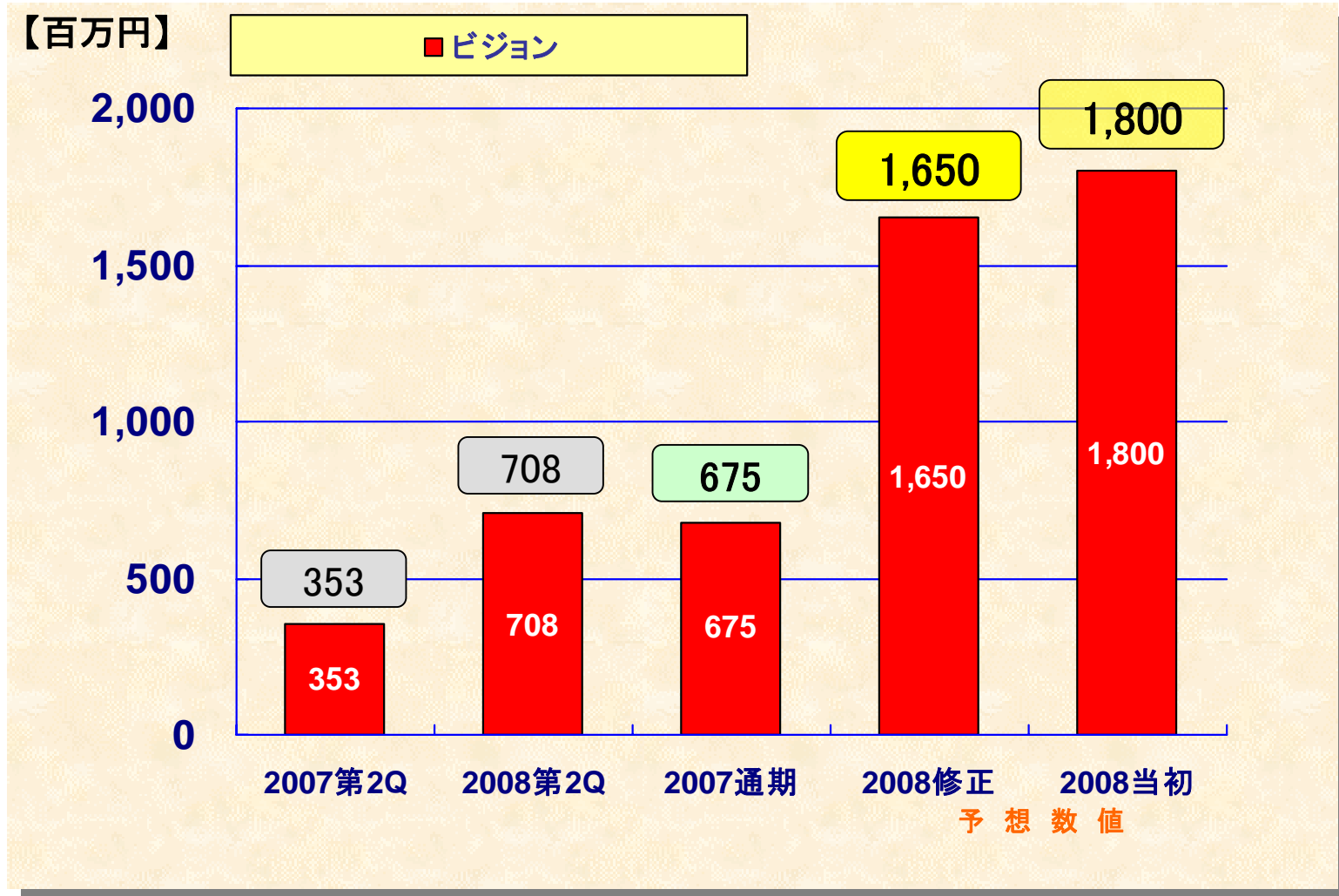
1. 事業概要
2. 売上推移と2008年度見通し
3. 主要製品別進捗状況
4. 今後の課題と事業戦略

1. 事業概要

- ・従来の装置事業より、VISION技術(画像処理技術)を分離した事業部として2008年4月に発足し、計画通りVISION技術の運営を行っております。
- ・商談案件については順調に推移していますが、業界の急激な事業環境変動により納入が来年度にずれ込むケースも出てきておりますが、随時計画的な展開を図ります。
- ・当事業部としては今年度利益は非常に厳しい状況ですが、前期比4億円の改善を図り、黒字化を目指します。
- ・「開発・研究」、「生産拠点」及び「営業」を事業の3大柱としTCLのブランド力の向上に努めております。
- ・今後は、国内・韓国及び台湾のLCD/PDP/フィルム業界だけでなく、ワールドワイドな事業活動を図り、欧州等への展開も視野に入れております。

2. 売上推移と2008年度見通し

OVIS事業 (過年度は、従来の装置事業より「ビジョン」を分離して表示しております。)



3. 主要装置別進捗状況

【Promise System】(新偏光板切断システム)

- ・韓国メーカーより1台受注し、現在複数台の追加商談中です。
- ・国内メーカーに納入検討中。技術的優位性が確立できれば2008年度末納入予定
- ・台湾メーカー複数社に対して積極的に拡販中。

【Dream System】(ROOL偏光板貼合せシステム)

- ・台湾メーカー複数社にて、性能評価中。

【Laser Slitter】

- ・韓国メーカーより1台受注し、現在複数台の追加商談中です。
- ・国内、海外メーカーより要求殺到し、新規商談中。

【多機能検査装置】

- ・国内メーカーから受注に成功し2008年度量産ラインに納入予定です。

4. 今後の課題と事業戦略

- ・ プロセス技術とVISION技術(画像処理技術)を融合したシステムエンジニアリングを核としたプロセス装置システムおよび関連モジュール製品の設計・製造および販売を行う。
- ・ 新製品(レーザ技術応用システム、大型TV検査システム等)の開発を行いカスタムメイク技術力を高め、TOTALシステムの提供を行う。
- ・ 「開発・研究」「生産拠点」を九州事業所に設置し、人材の集中と資源投下を実行中。なお、営業は大阪・東京の2拠点とし営業力及びCS力の向上に推進中。
- ・ 全ての競合ファクター(技術・価格・納期・顧客対応等)において、競合他社を圧倒する強い事業組織確立の為、部品メーカーとのアライアンスの強化。
- ・ ワールドワイドな販売・メンテナンス強化の推進を行う為、一部商社とも協業を進める。

本資料の取り扱い上の注意

本資料に含まれる本年度見通しに関する記述は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した数値であり、多分に不確定要素を含んでおります。従いまして、実際の業績等は、業況の変化等により、記載した予想数値と異なる場合がありますことをご了承ください。

ご清聴ありがとうございました。
今後も引き続き、ご支援よろしくお願いいたします。